

銅上の無電解金めっきプロセス
Electroless Au Plating Process on Cu

銅上の無電解パラジウム/金めっきプロセス
Electroless Pd/Au Plating Process on Cu

トップギルドプロセス

TOP GILD PROCESS

トップパラスプロセス

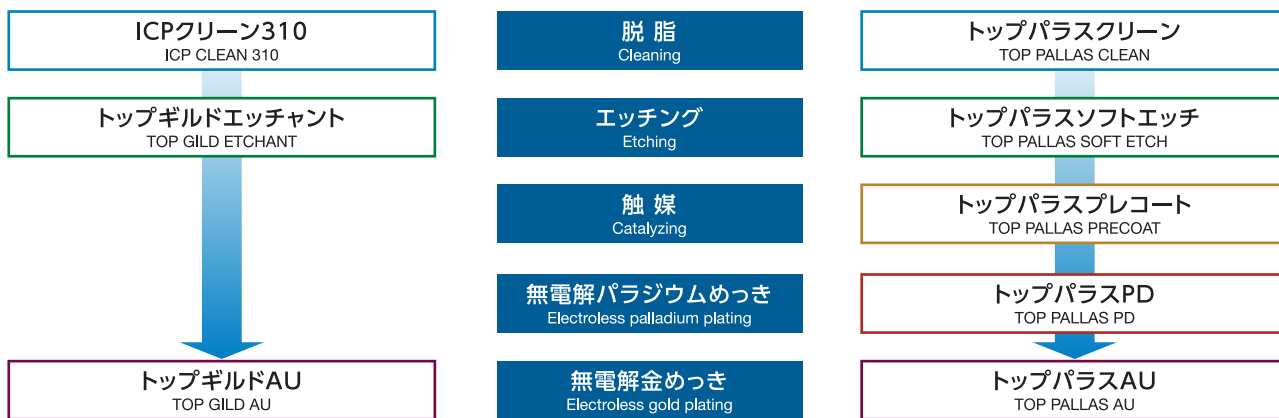
TOP PALLAS PROCESS

- 銅上の金析出性が良好
High deposition ability of gold plating on copper
- 下地銅の腐食がほとんど無く、つきまわり性が良好
Prevent copper damage, excellent in covering performance
- ファインパターン性に優れる
Excellent in fine pattern ability
- Roll to Roll仕様にも対応
Applicable to Roll to Roll plating system

- 銅上のパラジウム析出性が良好
High deposition ability of palladium plating on copper
- はんだ接合性、金ワイヤボンディング性に優れる
Excellent in solder joint, gold wire bonding performance
- 耐折性、耐食性が良好
High folding endurance, great corrosion resistance
- ファインパターン性に優れる
Excellent in fine pattern ability

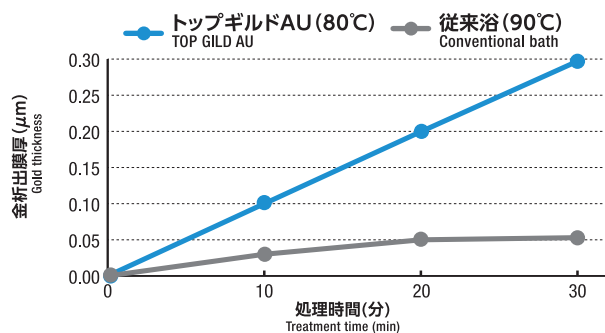
処理工程

Process



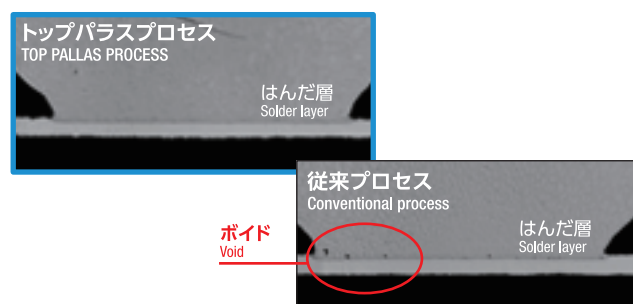
良好なめっき析出性

Excellent in deposition performance



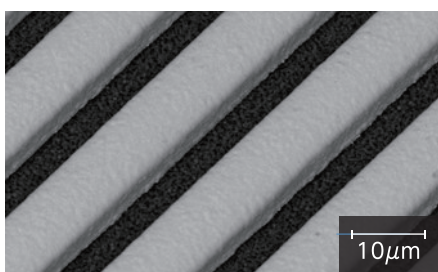
優れたはんだ接合性

Excellent in solder joint performance



優れたファインパターン性

Excellent in fine pattern ability



良好な屈曲性

Excellent in folding endurance

